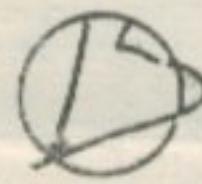


Микросхемы гибридные

ПАСПОРТ

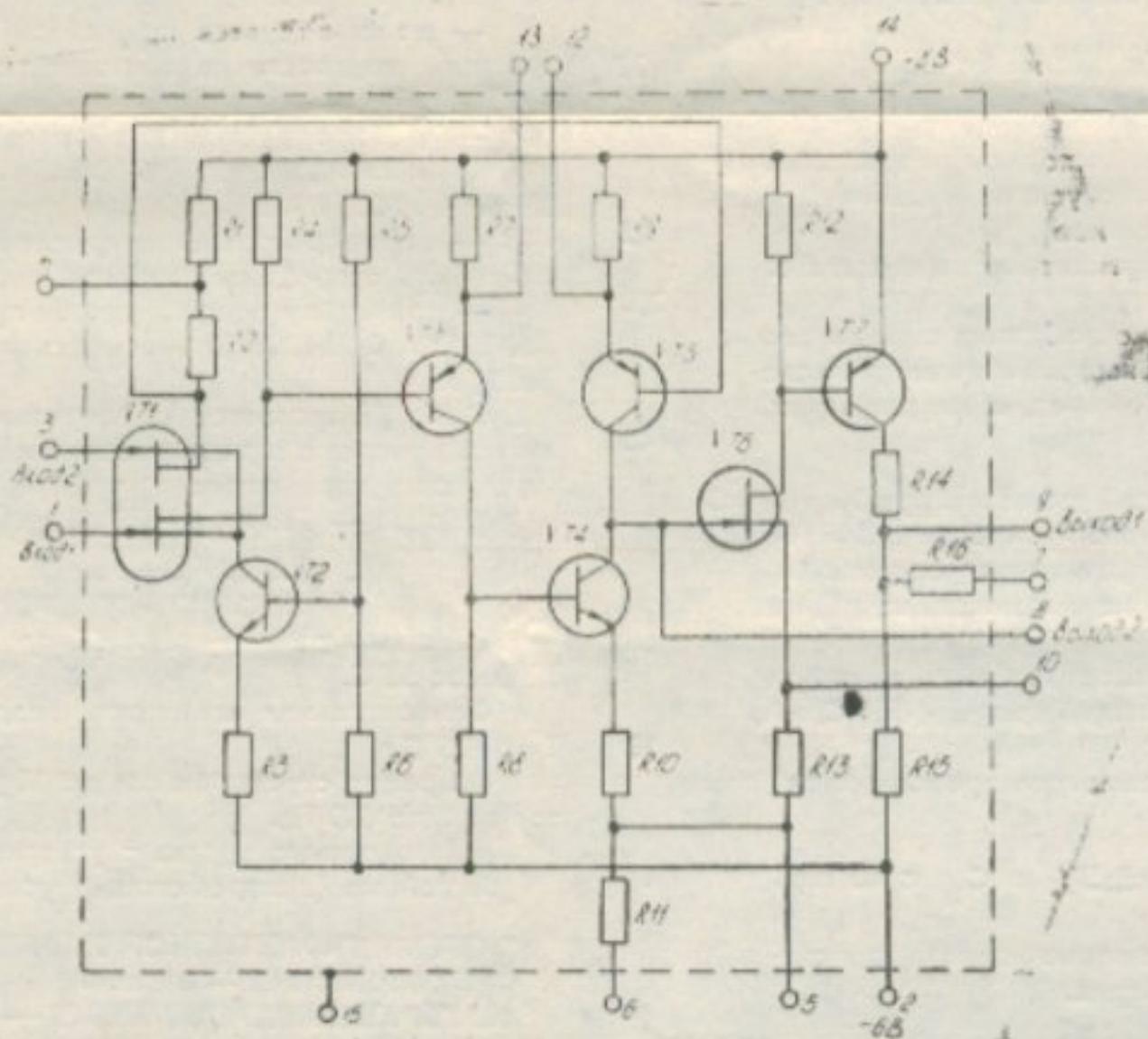
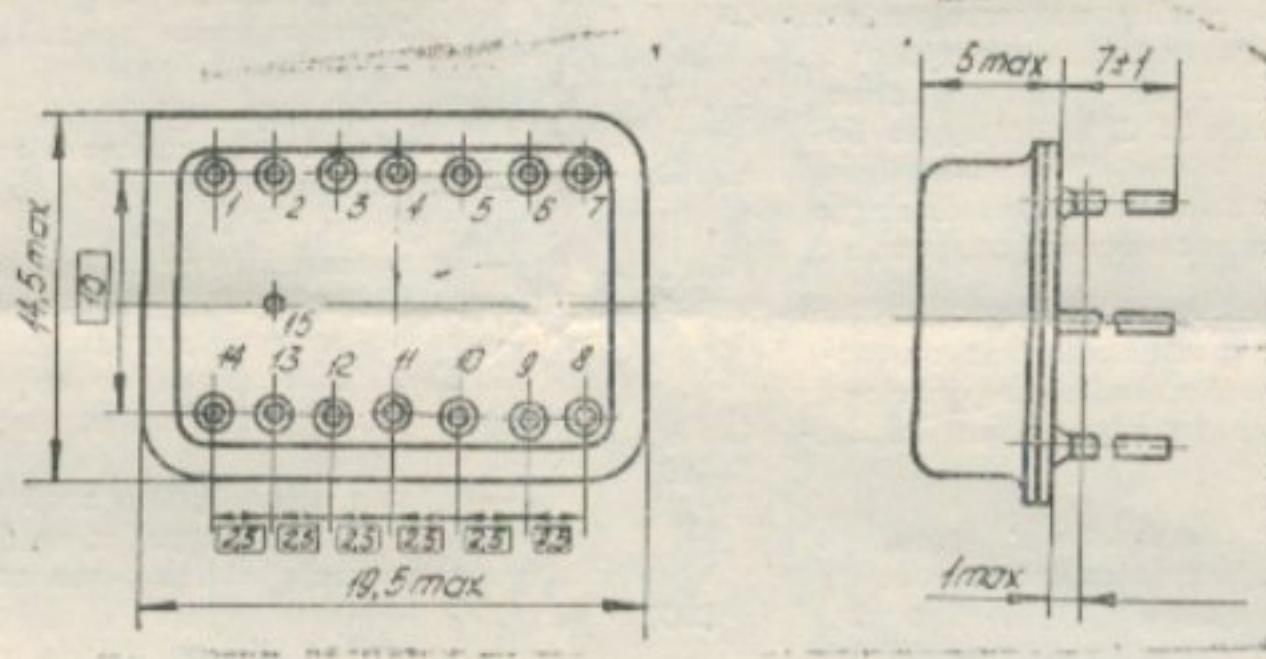
Микросхема К284УД2 соответствует техническим
условиям 0,348. 099 ТУ



1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Схемы селекции и сравнения, представляющие собой усилитель с дифференциальным входом, предназначенные в основном для активных ВС — фильтров.

2. ГАБАРИТЫ: 14,5x19,5x5 мм.



3. РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

- а) напряжение питания плюс 6 В $\pm 10\%$
минус 6 В $\pm 10\%$
б) мощность потребляемая от источника питания,
мВт, не более 80.

4. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметров	Норма
1° Коэффициент усиления на частоте 40 Гц при изменении температуры от минус 40° С до плюс 25° С, не менее от плюс 25° С до плюс 55° С, не менее	5000 2000
2° Температурный дрейф напряжения смещения нуля при изменении температур от минус 45° С до плюс 25° С мкВ/град., не более от плюс 25° С, до плюс 55° С, мкВ/град., не более	± 600 ± 600
3° Напряжение смещения нуля на входе при нормальных климатических условиях, мВ, не более	± 20
4° Выходное сопротивление низкоомного выхода в режиме масштабного усиления с К=10 при нормальных климатических условиях, Ом, не более	10
5° Выходное сопротивление высокоомного выхода при нормальных климатических условиях, к Ом, не менее	300
6° Неравномерность частотной характеристики при нормальных климатических условиях и номинальных питающих напряжениях в диапазоне частот от 1 Гц до 40 кГц, дБ, не более от 1 Гц до 100 кГц, дБ, не более	22 40
7° Максимальное выходное напряжение в режиме масштабного усиления с К=10 при Кт=10/8, В, не менее	1,5
8° Входное сопротивление на частоте 40 Гц, М Ом, не менее	200
9° Коэффициент ослабления синфазного сигнала при нормальных климатических условиях и номинальных питающих напряжениях, дБ, не менее	40
10° Динамический диапазон при Иc/Иш=3 в режиме масштабного усиления с К=10 при нормальных климатических условиях и номинальных питающих напряжениях, дБ, не менее	60
11° Разность входных токов смещения при температуре окружающей среды +55° С, нА, не более	10

* Измерение параметров производится при

$$V_H = 12 \text{ к} \pm 5\% \text{ и } C_H < 40 \text{ пФ.}$$

** Иc/Иш — отношение напряжения сигнала к напряжению шума.

5. СОДЕРЖАНИЕ ЗОЛОТА НА 1000 шт. — 38,2489

6. УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ, МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

6. 1. Не допускается изгиб выводов на расстоянии менее 1 мм от корпуса до центра окружности изгиба, радиус изгиба выводов должен быть не менее 1 мм.

Зам. 192—5000.

6. 2. При лужении методом погружения в расплавленный припой:

- температура расплавленного припоя, °С, не более 250;
- время погружения, с, не более 2
- расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода), мм, не менее 1
- допустимое количество погружений, не более 2
- интервал между двумя погружениями, мин, не менее 5
- припой и флюсы по НО. 054. 063

6. 3. Установку микросхем на плату производить с зазором 1 + 0,5 мм. При установке микросхем допускается использовать прокладки из электроизоляционного материала.

6. 4. Рекомендации по пайке микросхем одножильным паяльником:

- температура жала паяльника, °С, не более 280
- время касания каждого вывода, с, не более 3
- расстояние от корпуса до места пайки по длине вывода, мм, не менее 1
- интервал между пайками соседних выводов, с, не менее 10
- жало паяльника должно быть заземлено

6. 5. Рекомендации по групповой пайке:

- температура расплавленного припоя, °С, не более 265

— время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы), с, не более 3 на расстоянии не менее 1 мм от корпуса (по длине вывода);

— интервал между двумя повторными пайками одной микросхемы, мин, не менее 6

6. 6. Рекомендации по очистке от флюса, влагозащите и приклейке:

— рекомендуется применять для очистки от флюса жидкости в соответствии с нормалью НО. 054. 063

— рекомендуется для влагозащиты применять лак УР-231, МРТУ 6-10-863-69 или Э4100, МРТУ 6-10-857-69

— после распайки микросхемы с платами должны быть защищены лаком не менее, чем в 2 слоя

— приклейку рекомендуется производить kleem AK-20 ТУ 6-10-1293-72 или мастикой «ЛН», ТУ МХП 3052-55.

6. 7. Допускается однократный монтаж микросхем на платы с гарантированным сохранением электрических параметров при формовке выводов и двукратный — без формовки выводов.

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 45° С до плюс 55° С.

Относительная влажность воздуха до 98% при $T = +25^\circ\text{C}$.

Вибрация с ускорением до 10g в диапазоне частот от 1 до 600 Гц.

Многократные удары с ускорением 75 g.

Линейные (центробежные) ускорения до 25 g.

8. ВРЕМЯ ГАРАНТИЙНОЙ НАРАБОТКИ — 10000 ч.
СРОК ХРАНЕНИЯ — 6 лет.

10. ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ — ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Гарантии исчисляются со дня отгрузки микросхем потребителю.

11. МАССА — 4,5 г.

12. ДАТА ВЫПУСКА

Штамп ОГН 197 г.
БТК 05-26